证券代码：688449 **证券简称：联芸科技**

联芸科技（杭州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议）
参与单位名称	Point 72、安信基金、财通资管、创金合信基金、东方阿尔法基金、东方红资管、富安达基金、富国基金、光大富尊、光大永明、广发基金、国金基金、国联安基金、国联基金、恒大人寿、湖南轻盐创投、华安基金、华宝基金、华泰证券、华夏基金、汇丰晋信、嘉实基金、建信基金、开源证券、量函私募基金、摩根士丹利基金、南方基金、诺安基金、鹏华基金、平安基金、浦银安盛、前海开源、融通基金、睿远基金、山西证券、申万宏源证券、申万菱信基金、新华基金、信达澳亚基金、阳光资管、易方达基金、银河基金、银华基金、永赢基金、长城基金、长信基金、中金基金、中银基金、中邮人寿，以及线上参与2026年第三季度业绩说明会的投资者
时间	2026年10月29日、2026年11月9日
地点	电话会议、价值在线（https://www.ir-online.cn/）
上市公司接待人员姓名	董事长 方小玲 董事会秘书、财务总监 钱晓飞 独立董事 朱欣 独立董事 孙玲玲
投资者关系活动主要内容介绍	**1.请问董秘，公司在扣非净利润只有7000多万的情况下，研发投入却有5个多亿，在普遍使用AI的情况下，公司是否有使用AI工具提升效率以替代部分人工的计划？公司研发投入如如此大，是否取得了重大的可应用成果？请回复，谢谢！**

	答：尊敬的投资者，您好！公司已关注到AI工具在半导体领域的应用趋势，并已开展相关投入，正结合自身业务特点，积极推进AI工具在辅助研发、优化管理等各方面应用。目前AI工具以赋能为主，效能释放仍需持续打磨，长期来看有望助力优化研发环节、降低研发相关费用。公司2026年前三季度研发投入5.16亿元，同比增长41.49%，占营业收入的比例为37.69%；公司基于发展战略及规划，持续在企业级存储主控芯片、嵌入式存储主控芯片等新产品技术方面保持较高的研发投入。公司为保持在市场端的竞争力，持续研发新一代存储主控产品、丰富产品类型、保障供应能力，以应对下游客户多样化的需求和市场风险。未来，随着业务规模扩大，公司将不断提升研发资源的使用效率，根据项目进展和市场需求，持续动态优化研发资源配置，提升投入产出效率。感谢您的关注！ **2.公司企业级PCIe5.0主控仍处量产测试，请问是否已经通过客户端测试？如未通过，预计何时能通过客户端测试？何时能开始贡献营收？** 答：尊敬的投资者，您好！2026年初，公司企业级PCIe5.0主控芯片进入量产测试阶段。截至目前，该芯片已基本完成客制化方案开发，将于本月向终端客户送样；现阶段该产品暂未实现批量销售，后续商业化进展请持续关注公司公告。感谢您的关注！ **3.请问公司今年12月底会完成20.6亿元，定向增发吗** 答：尊敬的投资者，您好！公司向特定对象发行A股股票已取得中国证监会同意注册的批复，后续将择机启动发行工作。本次发行的具体时间、发行对象及发行价格将根据竞价结果确定，并严格遵循中国证监会、上海证券交易所的相关规定。相关进展情况将及时通过公告披露，敬请投资者以公司正式公告为准。感谢您的关注！ **4.针对联芸近期股票价格下跌，公司有计划采取哪些维护股价的措施？谢谢** 答：尊敬的投资者，您好！二级市场股票价格受到宏观经济形势、市场整体环境等多重因素的影响。公司高度重视市值管理与全体股东长期利益，将持续聚焦主营业务，扎实推进提质增效，不断夯实经营基本面；同时严格执行《市值管理制度》，并持续优化投资者关系管理机制，及时回应市场关切，切实增强投资者信心。感谢您的关注！ **5.公司独立固态硬盘主控芯片出货量全球第二，全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术的企业之一。请结合股价周线、月线和年线走势，对比半导体、存储芯片板块说明一下公司经营是否出现问题?有没有市值管理的措施?比如说回购股份、投资者回报分红等。** 答：尊敬的投资者，您好！股价走势受宏观环境、板块情绪等多重因素共

	同影响。目前公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司已制定《市值管理制度》，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益。在投资者回报方面，公司2025年度利润分配方案已派发现金红利总额为2300万元（含税），已于2026年6月10日实施完成。公司高度重视股东回报，将结合自身经营状况、现金流水平、长期资本开支规划，积极评估股份回购、分红等回报方式；近期国家层面加大实施股票回购增持再贷款政策，公司也将同步关注相关政策工具。后续若有相关安排，公司将严格按照监管规则要求，履行内部审议程序并及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ **6.联芸科技企业级PCIe5.0主控仍处量产测试，请问是否已经通过相关企业测试？如未通过，预计何时能通过测试？何时能够规模量产？** 答：尊敬的投资者，您好！2026年初，公司企业级PCIe5.0主控芯片进入量产测试阶段。截至目前，该芯片已基本完成客制化方案开发，将于本月向终端客户送样；现阶段该产品暂未实现批量销售，后续商业化进展请持续关注公司公告。感谢您的关注！ **7.物联网芯片目前放量情况如何？** 答：尊敬的投资者，您好！目前公司AIoT业务产品主要聚焦感知与有线通信领域。其中感知信号处理芯片可覆盖交通出行、公共管理、工业物联网、智慧办公等应用场景；新一代车载感知信号处理芯片已通过AEC-Q100车规级可靠性认证，并于今年上半年实现量产，该芯片集成自研数字信号处理单元，能够支撑L2及以上高阶智能辅助驾驶系统的迭代升级，现已获得国内主流Tier 1客户定点，公司正积极推进产品导入更多终端车企。2026年第三季度，公司AIoT业务收入同比、环比均实现增长。后续公司将持续完善感知信号处理产品线布局，打造覆盖高、中、低端的完整产品矩阵，着力培育成为公司第二成长曲线。感谢您的关注！ **8.公司第三季度营收增长表现较好，但利润端表现不佳，请管理层拆解主要影响因素是什么？** 答：尊敬的投资者，您好！2026年第三季度，公司营业收入5.15亿元，同比增长65.51%，营收金额创单季度历史新高，主要得益于国内存储产业链及AIoT市场需求的结构性增长。公司持续提升产品竞争力、丰富产品矩阵，并深化与行业头部厂商的合作，推动数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片出货量大幅增长；归母净利润同比下降，主要系公司因战略配售持有的股份于第三季度确认大额公允价值变动损失所致。未来，公司将继续聚焦主营业务，推进产品迭代升级，持续丰富产品矩阵，提升产品性能与差异化竞争力；同时深化与行业客户及生态伙伴的合作，拓展应用场景

	和客户覆盖，提升产品销售规模，以更优异的业绩回报广大投资者。感谢您的关注！
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2026年10月29日、2026年11月9日